（上接 195 版）

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司、项目所属子公司、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站分别披露了《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》，前述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025年 4 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末金额	账户状态
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	0	已注销
	招商银行无锡分行	511903003310018	0	已注销
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	中信银行上海分行	8110201011501885643	0	已注销
	交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605	0	已注销
偿还银行贷款及补充流动资金	交通银行上海张江支行	310066865013009418191	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”

2、募投项目存在无法单独核算效益的情况

（1）伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2025 年 12 月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

（2）偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目主要为公司业务提供现金流及减少公司负债，降低财务费用，涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币 77,606.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2025]6-486 号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2025年 4 月 15 日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	58,938.02	58,938.02	2025年 4 月 29 日	2025年 4 月 27 日
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	18,488.01	18,488.01	2025年 4 月 29 日	2025年 4 月 27 日

截至 2025 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 180.07 万元，拟使用募集资金人民币 180.07 万元置换预先支付的发行费用，置换完成时间是 2025 年 5 月 28 日。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0 元。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2025年 4 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品		2025年 4 月 27 日	2026年 4 月 26 日	2025年 4 月 27 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2025年 4 月 15 日		
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行上海张江支行	7天通知	16,600.00	2025/4/30--2025/5/12	0.55
		结构性存款	10,000.00	2025/5/6--2025/5/27	9.49
		结构性存款	10,000.00	2025/6/3--2025/8/5	24.16
		结构性存款	3,000.00	2025/8/7--2025/8/21	1.38
		结构性存款	7,000.00	2025/8/7--2025/9/4	7.25
		结构性存款	2,000.00	2025/9/8--2025/9/16	0.53
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	7天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	1.56
		7天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	1.33
		结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	2.08
		7天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	0.83
		7天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	1.15
		7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	0.44
		7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	0.94
		结构性存款	5,000.00	2025/7/8-2025/7/30	4.78
		结构性存款	2,500.00	2025/8/19-2025/9/19	3.74
		结构性存款	1,500.00	2025/9/24-2025/10/10	0.86

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88 万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集专户均已注销，实际节余募集资金 8.17 万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间			2025年 4 月 15 日				
节余募集资金合计金额			8.17				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	3.01	用于补流					
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	5.04	用于补流					
偿还银行贷款及补充流动资金	0.12	用于补流					

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，伟测科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了伟测科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

平安证券股份有限公司认为，伟测科技 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对伟测科技 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券									
募集资金到账日期			2025年 4 月 15 日									
本年度投入募集资金总额			116,361.71									
已累计投入募集资金总额			116,361.71									
变更用途的募集资金总额			不适用									
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	生产建设		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,018.42	18.42	100.03	2025年9月	不适用	不适用	否
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	生产建设		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.10	0.10	100.00	2024年12月	25,528.27	是	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	还贷及补流		27,500.00	27,500.00	27,500.00	26,343.18	26,343.18	-1,156.82	95.79	不适用	不适用	不适用	否
合计			117,500.00	117,500.00	117,500.00	116,361.71	116,361.71	-1,138.29	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详情请见报告正文“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详情请见报告正文“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			详情请见报告正文“三、(五)节余募集资金使用情况”										
募集资金其他使用情况			不适用										

注 1：本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。因本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”不足部分由公司自筹解决。

注 2：伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目本期实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。本期为该项目建设完毕后第一年，本期收入已达到预计效益。

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-020

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海伟测半导体科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为每人税前人民币 8 万元 / 年，按季度发放，无须考核；

2、非独立董事（含职工董事）

1）在公司任职的非独立董事，其年薪标准根据其在公司的任职的具体岗位领取相应薪酬，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬；

2） 在公司任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬；在公司任职的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员 2026 年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平， 由公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益；

3、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届薪酬与考核委员会第十三次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-023

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
公司合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或 纳入合并报表范围内的子公司）	75.00 亿元	29.48 亿元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	29.48 亿元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	99.35
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额 （含本次） 达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围内的子公司，下同）的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2026 年度发展计划，保证公司业务顺利开展。2026 年度公司拟为全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）和成都伟测半导体科技有限公司（以下简称“成都伟测”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 75.00 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司总经理或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，全权办理对外担保相关的具体事项，担保额度及授权的有效期为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	无锡伟测	100%	71.85%	29.48 亿元	75.00 亿元	252.75%	经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。	否	否
	南京伟测	100%	84.88%						
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	成都伟测	100%							

注 1：成都伟测于 2026 年 1 月注册成立，主要资产尚处于投资建设期，未能形成经营效益，暂无最近一期资产负债率；

2、上表中截至目前担保余额的截至时点为 2026 年 3 月 31 日。

（四）担保额度调剂情况

在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司及全资子公司可根据实际情况对担保范围内的合并报表范围内的下属公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设合并报表范围内的下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	无锡伟测	全资子公司	公司持股 100%	91320214MA21NM9A6P
法人	南京伟测	全资子公司	公司持股 100%	91320111MA2798JE32
法人	成都伟测	全资子公司	公司持股 100%	91510100MAK676F33R

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2024年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）					2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
无锡伟测	206,178.78	129,359.11	76,819.67	67,765.05	12,085.80	345,355.14	248,121.75	97,233.39	95,143.74	19,476.02
南京伟测	211,482.19	178,441.52	33,040.67	23,000.13	1,681.11	310,450.62	263,501.49	46,949.13	38,476.57	1,954.98
成都伟测										

（二）被担保人失信情况

经查询，以上被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于 2026 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合公司目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为人民币 29.48 亿元，均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 99.35%和 38.16%。截至本公告披露日，公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-019

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 303,198,635.91 元；经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。以截至 2026 年 4 月 2 日的公司总股本 167,764,661 股为基数测算，拟派发现金红利 92,270,563.55 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.43%；

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配的现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

本次方案尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	92,270,563.55	38,814,330.30	36,279,651.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,198,635.91	128,228,784.44	117,996,286.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	189,861,086.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	167,364,545.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	183,141,235.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	167,364,545.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	91.39		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	418,195,186.30		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,388,037,119.92		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	12.34		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

1、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。审计委员会同意本次利润分配方案。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。

三、相关风险提示

1、公司 2025 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求及股本等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次方案尚需股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-027

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2025 年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2025 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,351.14 万元，具体如下：

项目		2025年度计提本期金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	908.45
	其他应收款坏账损失	236.80
资产减值损失	长期待摊费用减值损失	1,205.88
合计		2,351.14

注：上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年度计提信用减值损失金额共计 1,145.25 万元。

（二）资产减值损失

公司资产减值损失为长期待摊费用减值损失。在资产负债表日，对长期待摊费用按照可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。因南京伟测半导体科技有限公司自有厂房已完全投入使用，以前年度租赁的厂房将不再继续使用，公司于 2025 年 12 月与出租方签订终止租赁协议。退租长期租赁资产对应的装修费用预计产生损失，计提长期待摊费用减值准备 1,205.88 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025 年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 2,351.14 万元，对公司合并报表利润总额影响数 2,351.14 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与 2025 年年度审计报告一致。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-037

深圳市禾望电气股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了 2026 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司 2023 年第四次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司〈2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“君泽君律师”）出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在公司网站对首次授予激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 11 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 4 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》，并公告了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第五次临时董事会会议和 2023 年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，同意以 2023 年 4 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 350 名激励对象首次授予股票期权 2,247 万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2023 年 8 月 2 日，公